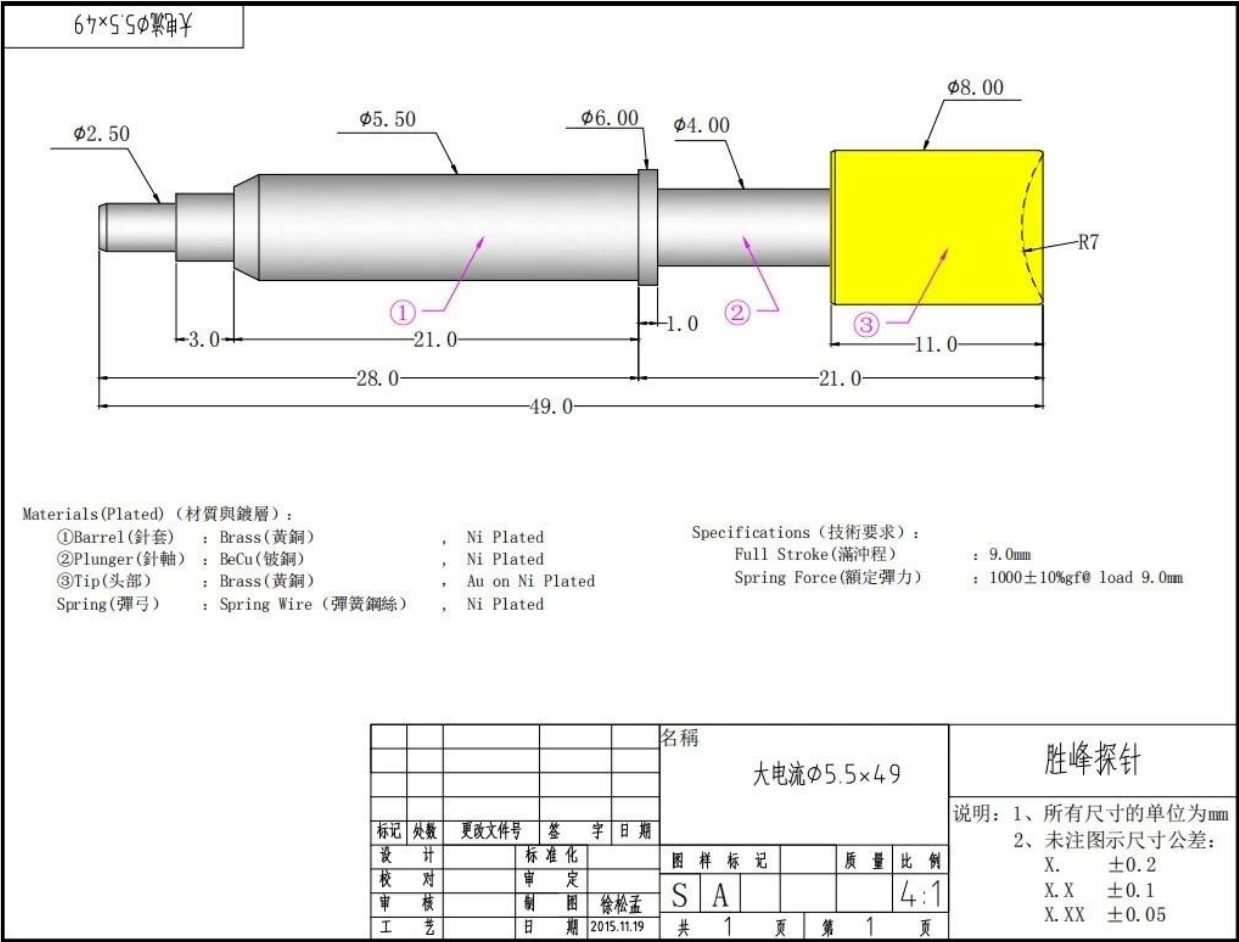




SFENG 1984 () ()



	SF-5.5*49
	9.0mm
	1000±10%gf@9.0mm
	CuNi Ni Ni
MOQ	100
	7



1. 24
2. OEM
- 3.
- 4.



1. PCB, ICT, FCT
2. 2
3. BGA
4. QZ, VZ, LM
- 5.
- 6.
7. 30# OK, POM



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



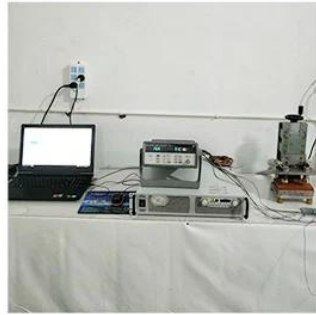
4. Quality inspection



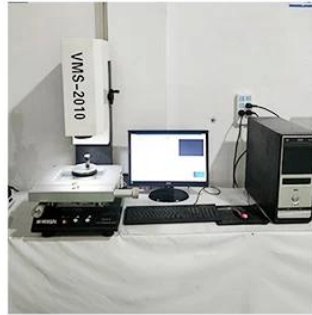
5. Finished products



6. Packing



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope



2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe



□□□□□□□DHL□UPS□FedEx□TNT□EMS□□□□□□□□

Exwork FOB CNF CIF



Q1.

A1:

Q2.

A2: QC 1

Q3.

A3:

Q4.

A4:

Q5.請問公司目前主要產品？

A5: 目前主要產品為各類電子產品，包括手機、平板電腦、筆記本電腦、智慧電視、智慧家電等。

Q6.請問公司目前主要市場？

A6: 目前主要市場為中國大陸、東南亞、歐洲、北美洲等。

Q7.OEM與ODM有何區別？

A7: OEM (Original Equipment Manufacturer) 是指客戶提供產品設計和規格，由我們負責生產和組裝。ODM (Original Design Manufacturer) 是指我們負責產品設計和開發，客戶負責生產和組裝。

Q8.請問公司目前主要客戶？

A8: T/T, L/C 等。MOQ 1000 個。L/C 1000 個。